(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年8 月10 日 (10.08.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/082744 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/301202

(22) 国際出願日: 2006 年1 月26 日 (26.01.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-026787 2005 年2 月2 日 (02.02.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニーケミカル株式会社 (SONY CHEMICALS CORP.) [JP/JP]; 〒1410032 東京都品川区大崎１丁目１１－２ ゲートシティ大崎イーストタワー８階 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 蟹澤 士行 (KANISAWA, Shiyuki) [JP/JP]; 〒3228503 栃木県鹿沼市上石川１０７８ ソニーケミカル株式会社 鹿沼事業所内 Tochigi (JP).

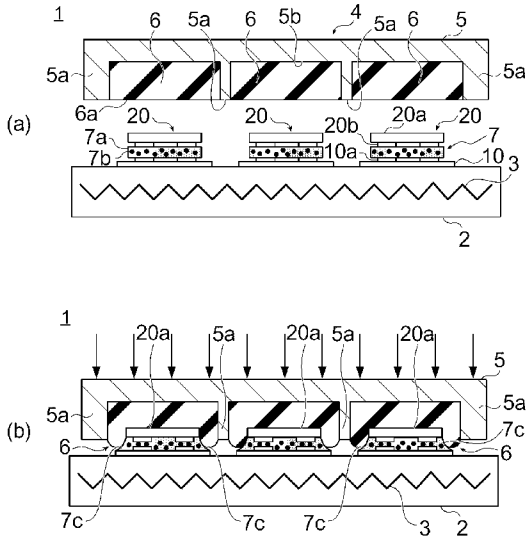
(74) 代理人: 阿部 英樹，外(ABE, Hideki et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門１丁目２－１８ 虎ノ門興業ビル３階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO,

[続葉有]

(54) **Title:** ELECTRIC COMPONENT MOUNTING APPARATUS

(54) **発明の名称:** 電気部品の実装装置



(57) **Abstract:** A mounting apparatus for mounting a plurality of electric components with high reliability by using an adhesive. The mounting apparatus is provided with a thermal compression bonding head (4) having a compression bonding member (6) composed of a prescribed elastomer on a head main body (5). The mounting device is configured to press the compression boding member (6) to an IC chip (20) arranged on a wiring board (10) by a prescribed pressure, and is provided with a pressing force adjusting mechanism for adjusting a pressing force corresponding to a region on a compression bonding plane (6a) of the compression bonding member (6). As the pressing force adjusting mechanism, a mechanism wherein a plurality of pressing force adjusting frames (5a) are provided on the head main body (5) and the compression bonding member (6) is arranged inside such pressing force adjusting frames (5a) can be used.

(57) 要約: 本発明は、接着剤を用いて複数の電気部品を高信頼性で実装が可能な実装装置を提供するものである。 本発明は、ヘッド本体５に所定のエラストマーからなる圧着部材６を有する熱圧着ヘッド４を備え、配線基板１０上に配置されたＩＣチップ２０に対して圧着部材６を所定の圧力で押圧するように構成された実装装置であって、圧着部材６の圧着面６ａの領域に応じて押圧

[続葉有]

WO 2006/082744 A1

RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

力を調整する押圧力調整機構が設けられているものである。押圧力調整機構としては、ヘッド本体５に押圧力調整枠５ａを複数設け、これら押圧力調整枠５ａの内側に圧着部材６を配置したものを用いることができる。